

第 14 回 有機/無機接合研究委員会

日時：2022 年 10 月 18 日（火）13:00～16:00

場所：日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階 911-913 会議室（東京都中央区）

プログラム

司会 荘司 郁夫（群馬大学）

13:00～13:10 委員会議事

13:10～13:50

『半導体（パワーデバイス）後工程組立と評価について』（40 分）

..... ○小野寺 浩（シーマ電子(株)）

13:50～14:30

『微細樹脂-Si 複合電極プローブの作製と表面処理』（40 分）

..... ○水寄 英明^{*1}、佐藤 彰^{*2}、納富 健司^{*2}
（^{*1}長野県工業技術総合センター、^{*2}タカノ(株)）

14:30～14:40 休憩

司会 山口 敦史（パナソニック インダストリー（株））

14:40～15:20

『金属箔を使用したストレッチャブル基板およびフラット基板の開発』（40 分）

..... ○中尾 凌（東洋アルミニウム(株)）

15:20～16:00

『伝送損失低減を狙った新しい熱硬化型フィルム』（40 分）

..... ○高 明天（太陽インキ製造(株)）

（ ）内時間は、質疑応答時間を含む

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。
一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会